2026 年投資人議合情形

合勤控重視投資人之意見與建議，致力於建立透明、暢通的雙向溝通機制，透過持續性的交流與議合，深入了解投資人所關注之重大議題。為強化與投資人之互動，本公司透過實體會議、電話及法人說明會等多元管道，積極回應投資人關切事項，促進雙方資訊交流與理解。

一、2026 年度合勤控與投資人之溝通議合情形及相關統計數據如下：

議合方式	法人說明會	親自拜訪	視訊	電話或電子郵件
次數	1 次	6 次	2 次	不定期

二、2026 年度投資人議合之重要提問及公司回覆如下：

投資人提問	公司回應
如何看待集團 2027 營收成長機會?	2027 年成長動能來自市場佈局、技術升級與製造韌性。深化全球一級電信商合作，區域聚焦南亞、南美、東南亞及紐澳新動能。國防市場過去一至兩年皆有顯著成長，2027 年將持續作為重要成長引擎之一。
請問半導體零組件備料期間有多長？第三季是否開始採用高成本記憶體生產？毛利率如何因應？	由於 AI 需求排擠整體半導體產能，主被動元件與記憶體的 Lead time 皆非常長，且零組件普遍漲價。 公司採取計劃性策略備料，這也是季底存貨金額拉升的主因。運營商對零組件價格飆漲的承受度已達極限，公司將視客人對成本的反應，動態協商漲價與備料節奏以維護競爭力。
目前主要的生產基地與越南廠擴建進度？	目前主力生產基地仍在中國無錫。越南廠今年度已啟動試產，預計 2027 年正式加入量產擴產，提升產能配置彈性並分散地緣政治風險。